

“第二十五届中国覆铜板技术研讨会”征文通知

随着我国电子信息产业的快速发展，目前中国覆铜板产销量位居世界首位，覆铜板自主创新与技术水平得到快速提升。为了推进我国覆铜板技术的创新突破和行业持续高质量健康发展，中国电子材料行业协会覆铜板材料分会（CCLA）拟定于2024年10月，在江西省九江市举办“第二十五届中国覆铜板技术研讨会”。

CCLA自2000年举办“第一届中国覆铜板技术研讨会”以来，已成功举办了24届“中国覆铜板技术研讨会”。它已成为我国覆铜板行业中，最高层次、唯一的技术交流盛会，也是全面展示全球及我国覆铜板产业链新技术成果的平台。

本届技术研讨会将邀请覆铜板产业链企业、科研院所的知名专家、技术人员，聚焦覆铜板产业链制造技术的热点话题展开探讨。CCLA现面向行业专家、企业及科研院所的科研工作者征集论文，欢迎业界人士积极投稿。

本次征集的全部论文，经过“覆铜板行业技术委员会”专家评选出优秀论文之后，收录至《第二十五届中国覆铜板技术研讨会论文集》中，将被“中国知识资源总库”、“维普期刊数据库”所收录。同时，组委会将邀请优秀论文作者在大会上发表主旨演讲，并向优秀论文作者颁发“2024年CCLA杯优秀论文奖”。

“第二十五届中国覆铜板技术研讨会”征文的具体要求如下：

一、论文征集范围及内容

覆铜板、上游原材料、下游印制板、设备、仪器、终端整机电子产品等相关行业。论文内容可以参考以下课题：

- ◆ 刚性覆铜板、挠性覆铜板、特种覆铜板及PCB用其它基板材料产品的技术研究及应用；
- ◆ 对PCB基板材料的新理念、新技术、新市场发展趋势的研究；
- ◆ 覆铜板用原材料、设备、仪器等新技术的研究及应用；
- ◆ 覆铜板制造业的智能制造的成果与研究；
- ◆ 覆铜板环保、节能减排等课题的研究及应用；
- ◆ 覆铜板新标准、新测试技术的研究及应用；
- ◆ 其它与覆铜板发展相关的问题探讨。

二、论文提交

第①步：提交论文摘要

2024年7月31日前，提供论文题目、内容摘要。

▲摘要提交要求：

1. 论文摘要要求能够清楚表述论文中心内容、关键论点及重要性。
2. 公司名称、作者信息（工作单位、联系方式）。

第②步：提交论文全文

2024年8月30日前，提供论文全文 Word 电子版。

▲论文格式要求及注意事项：

1. 论文应包括题目、内容摘要、关键词、正文、参考文献、作者姓名、单位、第一作者简介、联络方式。
2. 论文正文字数 5000~10000 字。
3. 送交的论文，未在国内其它会议、媒体、专业杂志上公开发表过。
4. 论文涉及的本企业产品、技术成果应拥有自主创新性。

（提交的论文，无论采用与否，一律不予退回。）

第③步：论文评选及发表

2023年9月15日前，由“覆铜板行业技术委员会”专家评选出2023年CCLA杯优秀论文及研讨会演讲论文。

选为大会讲演的论文，于2024年9月30日前提供演讲PPT。

▲本届研讨会组委会将评审通过的论文收录进《第二十三届中国覆铜板技术研讨会论文集》，供会议代表交流。《中国覆铜板技术研讨会论文集》是中国知识资源总库——中国重要会议论文全文数据库收录文献，如作者不愿被收录，请声明；凡不声明者，即视为同意收录。凡被收录的论文，在本届大会召开前，请勿在其它会议上发布。

三、投稿请联系方式

联系人：王爱戎 13571002871 董榜旗 15667263899

电 话：029-33335234

E-mail: ccla33335234@163.com

欢迎大家踊跃投稿参会！

【相关链接】

- ◆ CCLA 成功举办第二十三届中国覆铜板技术研讨会